

株主メモ

事業年度 1月1日から12月31日まで

定時株主総会 3月

基準日 定時株主総会 12月31日
剰余金の配当 期末 12月31日
中間 6月30日

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先・照会先 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号(〒541-8502)
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
電話(通話料無料) 0120-094-777

公告の方法 電子公告とし、当社ホームページに掲載いたします。
(<http://www.daiichi-seiko.co.jp>)
ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

(ご注意)

1. 株主様の住所変更、買取請求、配当金の振込指定、その他各種手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっておりますので、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
2. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

ホームページのご案内

<http://www.daiichi-seiko.co.jp>

第一精工

検索

最新のトピックスをはじめ、業績報告や会社情報などをわかりやすくご案内してまいります。



株主・投資家
情報ページ

そして ミライの ために。

ちゃんとつくる



第一精工株式会社
第54期 年次報告書

平成28年1月1日～平成28年12月31日



代表取締役社長 小西 英樹

ダントツ商品の供給が本格化 持続的な成長基盤の確立へ

Q 第54期(平成28年12月期)の業績について

ノートパソコン、スマートフォン向けコネクタは苦戦も、自動車部品は過去最高を更新

まず、電気・電子部品事業は、ノートパソコンの販売不振やスマートフォンの成長鈍化により主力である超小型RF同軸コネクタや細線同軸コネクタの需要が減少したことに加え、上期を中心に急激な円高の影響を受け低迷しました。一方、FPC/FFCコネクタやBoard to Boardコネクタは、「ダントツ商品」を目指して開発した高周波ノイズ対策フルシールドコネクタの出荷が下期から本格化したこともあって伸長しました。HDD関連部品は、ノートパソコン向けの販売不振により低調でした。

次に、自動車部品事業は、北米や中国での自動車販売が堅調だったことと、カーエレクトロニクスの進展もあり、燃費や安全性

能の向上に寄与するセンサを中心に好調でした。加えて、LEDヘッドライト向けの自社ブランドコネクタも採用車種が順調に拡大したことから、自動車部品事業としての売上レコードを4期連続で更新することができました。

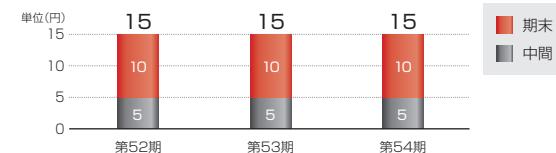
設備事業は、中国をはじめとする東アジアの景気不振懸念等から主要顧客である半導体メーカーに投資を控える動きがみられ、半導体封止装置や金型等の受注が低迷しました。

以上を受け、売上高458億円、営業利益4億円、経常利益8億円、親会社株主に帰属する当期純利益1億5千万円といずれも前期を下回りました。このような結果となりましたが、安定した配当を継続して実施していく基本方針のもと、経営環境等を総合的に勘案し、前期に引き続き期末配当金を1株当たり10円、中間配当を含む年間配当金を15円とさせていただきます。

業績ハイライト

売上高	45,834百万円 (前期比 6.0%▲)
営業利益	401百万円 (前期比76.7%▲)
経常利益	800百万円 (前期比65.8%▲)
親会社株主に帰属する当期純利益	157百万円 (前期比93.3%▲)

配当金の推移



Q 第55期(平成29年12月期)の重点戦略について

「ダントツ商品」が業績を牽引、自動車部品の需要拡大に備える

■ 電気・電子部品事業

フルシールドBoard to Boardコネクタは、パソコンやモバイル向けに採用が拡大すると見込まれることから、新製品を投入予定のFPC/FFCコネクタと合わせた売上を前期比1.7倍に伸ばす計画です。超小型RF同軸コネクタや細線同軸コネクタは、市場の拡大が見込めるロボットや医療分野をはじめ、IoT関連の新規需要を当社が得意とする高速伝送ソリューションで取り込む戦略を進めるほか、フルシールド細線同軸コネクタをパソコン向けに拡販します。HDD関連部品は、顧客ニーズである海外での生産・供給体制の確立と、顧客の工程の一部を担う新たなビジネスモデル(プロセスサポート)で業績の拡大に向けた取り組みを進めます。

■ 自動車部品事業

衝突回避や自動運転支援システムの普及を中心としてカーエレクトロニクスが一段と進展することから車載用センサをはじめとする電装部品の需要が継続して増加すると考えられます。また、自社ブランドコネクタもLEDヘッドライトへの採用が拡大しています。それらの需要を少しでも多く取り込めるよう国内外で生産体制の拡充を進めてきましたが、更に取り組みを強化し、当社のリソースを自動車ビジネスに柔軟に振り向けることができるよう組織を再編成し、工場増設にも着手します。また、自社ブランドコネクタの拡販と新製品開発にも引き続き注力します。

■ 設備事業

市場ニーズの拡大が見込める超薄型成形技術の開発、試作を継続し、開発成果を封止装置や金型等にフィードバックして市場投入する取り組みを進めます。また、封止装置で培った成形技術を応用した新規ビジネスの開拓にも継続して取り組みます。

■ 新規事業

「ダントツ商品」を目指して開発した*世界初の静電容量方式ト

ルクセンサ“エストルク”は、株式会社安川電機様の協調型産業用ロボットに搭載され、供給が本格化します。人とロボットが安全柵のない空間で協働することを実現した協調型ロボットへの搭載実績を、産業用ロボット市場だけでなく今後は医療や介護などの市場でも積極的にアピールすることで、“エストルク”の採用拡大に弾みがつくものと期待しています。この一環として、歩行リハビリ支援ロボットの普及を国内外で進めているリーフ株式会社と資本提携しました。提携による相乗効果を活かし、医療・介護分野への参入に繋げてまいります。

また、地震感知器に続くMEMS第2弾として、MEMSミラーデバイスの開発に成功しました。独自技術により従来品と比べ小型化を実現し、これまでレーザーを搭載できなかった装置にも用途が広がることを期待できます。これからもMEMSデバイスを搭載した「ダントツ商品」の発掘に取り組んでいきます。

*当社調べ

「ダントツ商品」で次の成長ステージへ

第53期より、各事業における将来の売上の2割以上を稼ぎ出すような未来の看板商品である「ダントツ商品」の取り組みを進めていますが、ご紹介しましたとおり序盤は着実に成果を上げつつあります。今後も新たな「ダントツ商品」を生み出し、それらが業績の牽引役となって当社を次の成長ステージに導くことを確実なものとするために、外部との協業や提携も含めた積極的な研究開発と投資を継続してまいります。

株主の皆様には今後とも当社グループへのご支援を何卒宜しくお願い申し上げます。

来期計画

■ 売上高	■ 経常利益	■ 親会社株主に帰属する当期純利益
500億円	22億円	15億円

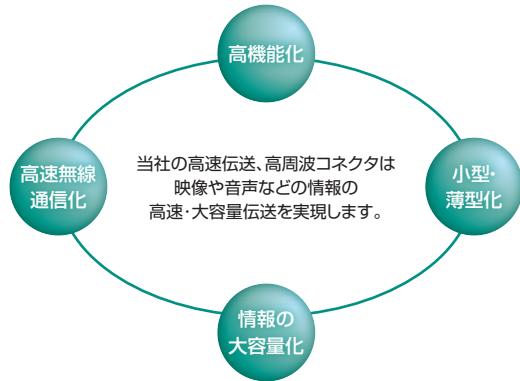
電気・電子部品事業

コネクタ及び同関連部品

より正確に、より緻密に。
「つなぐ技術」がここにはあります。



主にスマートフォンやタブレットなどのポータブル電子機器向けに、コネクタ(接続部品)を開発・製造し、「アイペックス」ブランドで世界市場に展開しています。最先端技術や規格に適合する製品をいち早く開発して市場をリードすることに力を入れており、ディスプレイ高精細化規格Embedded Display Port™(eDP™)や、薄型機器の高速化に対応する規格M.2(NGFF)など新たな規格を採用する電子機器に当社の高速伝送コネクタが多数採用されています。また、自動車、医療機器やロボット、ドローンなどの市場においても高速伝送ソリューションでお客様の幅広いご要望にお応えします。



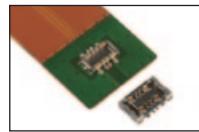
細線同軸コネクタ



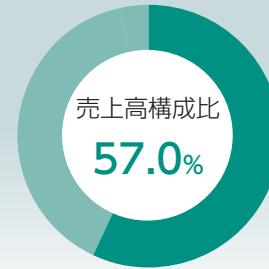
超小型RF同軸コネクタ



FPC/FFCコネクタ



Board to Boardコネクタ

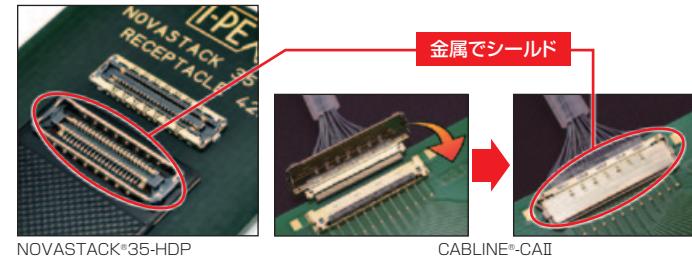


未来のダントツ

独自のフルシールド構造
次世代高速伝送対応コネクタを
ノートPC等向けに供給開始

電気信号伝送時の高周波ノイズがWiFiアンテナなどに干渉するEMI (Electro Magnetic Interference:電磁障害)の課題を独自の完全シールド構造により解決した高機能次世代高速伝送対応コネクタです。機器内の実装スペースが制限されるノートPCやモバイル機器などへの搭載が進んでいます。2017年は更に採用が拡大する見込みです。

*業界初!高周波ノイズを完全シールド



NOVASTACK®35-HDP

CABLIN®-CAII

*当社調べ

エレクトロニクス機構部品(HDD用機構部品等)



クラウド化によるデータセンターのサーバーや、パソコン、薄型テレビ、HDDレコーダー、カーナビ、ゲーム機などの記憶装置として、大容量化が進むHDD(ハードディスクドライブ)には今後も根強い需要が見込まれています。当社は、顧客との共同開発により世界で初めて量産化に成功した超精密樹脂部品ランプ(磁気ヘッド用ガイド部品)など、HDDに不可欠の機構部品を国内外のHDDメーカーに供給しています。



ランプはディスクの回転からの停止時や、比較的大きな振動を感知した際にディスク面が接触により傷つくことを防ぐため、データを読み書きする磁気ヘッドを待機格納させる部品です。

自動車部品事業



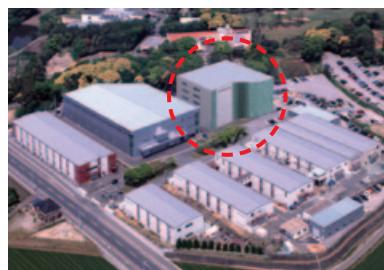
移動を支える先端へ、信頼の成形システムが安全へと導きます。

クルマは今や、電子機器の集合体といっても過言ではありません。安全かつ快適な走行のために過酷な条件下でも高い性能を保つ高感度センサが必需品となっています。また、衝突回避装置や自動運転技術の導入に伴い更に電子制御化が進むクルマには他の電子機器同様、コネクタ（接続部品）など各種電子部品が多数使用されています。当社は、センサ部品やコネクタをはじめ制御ユニットなど、精密金型と生産技術を駆使したさまざまな部品を供給しています。

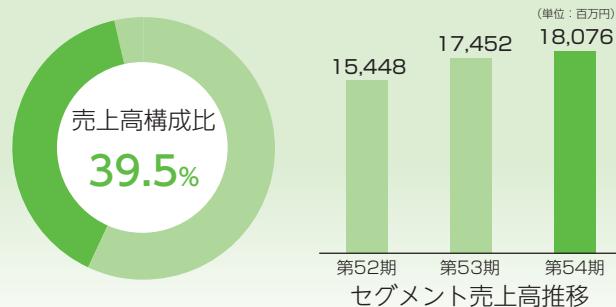
事業 TOPICS

自動車関連ビジネスの拡大に向けた取り組み

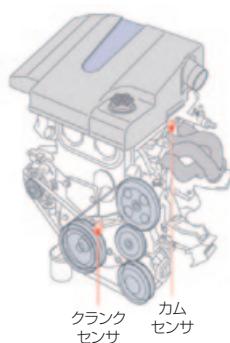
電子制御化の進展により拡大しているセンサ等の需要に対応するため、2018年から2019年にかけて国内外で工場増設を計画しています。



福岡県小郡工場増設イメージ



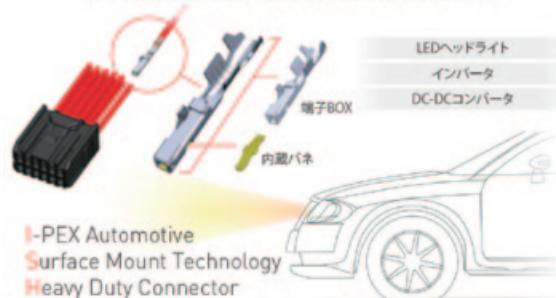
回転センサ



エンジンのクランクやカムの回転角と速度を検出するセンサ。回転角や速度を明らかにすることで、点火のタイミングや燃料噴射をコントロールすることが可能となり、CO₂の排出抑制や燃費の向上などに役立ちます。

車載向け自社ブランドコネクタ“ISHシリーズ”の特長

本体BOX部に高強度の内蔵バネを組み込むことで、高い接続信頼性を実現。



I-PEX Automotive Surface Mount Technology Heavy Duty Connector

設備事業

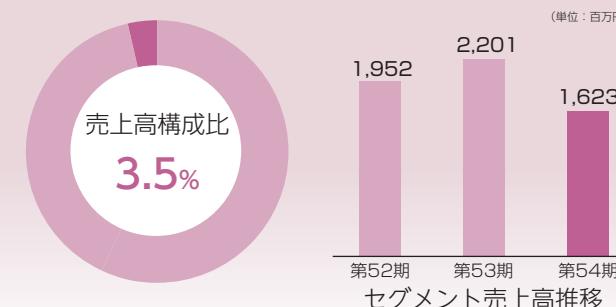


半導体量産に欠かせないモールドングを高精度かつスムーズに。

1980年、当社は精密金型技術を活かし、世界で初めて全自動半導体樹脂封止装置を発売しました。以来、国内外のお客様に装置を納入すると共に技術の向上を図り、現在では半導体製造関連装置、シリコン樹脂成形装置、樹脂成形周辺機器なども供給しています。大判化、薄型高密度などお客様の様々ご要望にこれまで培った独自のソリューションでお応えし、PC、モバイル、車載、LEDなどの幅広い業界で実績と信頼を積み重ねています。

半導体生産工程

半導体ができるまで



GP-PRO SP170(170t) 全自動半導体樹脂封止装置

各種展示会への出展

カーエレクトロニクスの進化に伴い、PCなど電子機器向けコネクタやロボット用センサ、樹脂成形技術など他の当社の事業領域にもビジネスチャンスが拡大することから、全社体制で各種展示会に出展しています。



2017年 第9回国際カーエレクトロニクス技術展



ネブコンジャパン 2016

「トルクセンサ」の供給が本格化

当社が開発した*世界初の静電容量型トルクセンサ“ESTORQ™(エステルク)”は、回転動作時のトルク（ねじり力）を検出して制御するためのセンサです。エステルクを使って人と接触したときにロボットの動きを制限する機能を持たせることで、従来必要だった安全柵なしで人とロボットが協働することが可能となります。2017年から株式会社安川電機の協調型産業用ロボット向けに本格的に供給が開始されます。*当社調べ



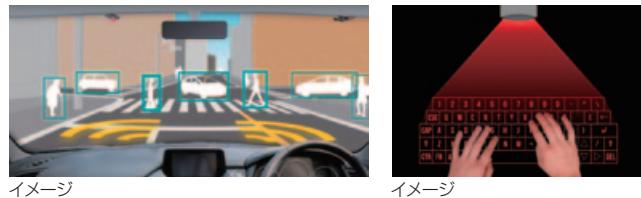
未来のダントツ *世界初! 静電容量型トルクセンサ



MEMS第2弾 MEMSミラーデバイスを開発

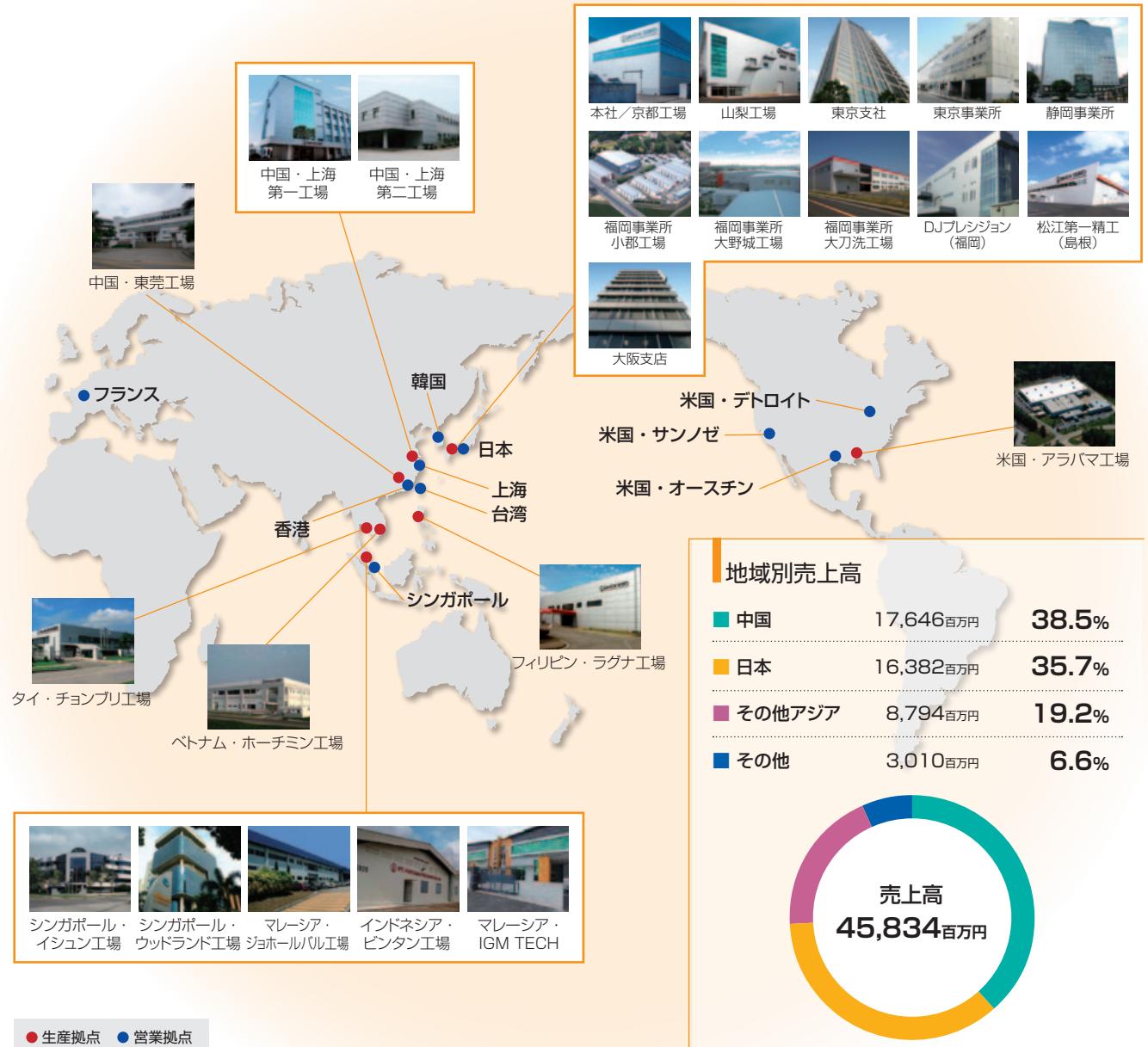
MEMS3軸加速度センサとそれを用いた地震感知器の開発に続き、*圧電薄膜を用いたMEMSミラーデバイスの開発に成功しました。自社開発の成膜技術により業界最小クラス(3.0×4.6mm)を達成し、自動運転時における安全走行用のレーザー走査スキャナーの小型化を実現する他、レーザーを搭載する各種検出装置に適したデバイスです。今後は自動車、情報通信、環境及び医療等の分野で製品化を目指してまいります。

*圧電薄膜 (チタン酸ジルコン酸鉛: PZT)



医療・介護ロボット分野への参入に向けた取り組み

ロボット市場へのビジネス参入の取り組みの一環として、介護ロボット促進の国家戦略特区に指定された福岡県北九州市に本社を置くリーフ株式会社（リーフ）と資本提携しました。リーフは、歩行リハビリ支援ロボットを国内外で販売するなど、医療・介護分野を中心にユニークかつ先進的な取り組みを行っているベンチャー企業です。今後、当社のトルクセンサをリーフのロボットに搭載して商品性を高めることや、新たな商品の共同開発などを通じて医療・介護ロボット分野での取り組みを進めてまいります。



POINT 上期急激な円高の影響もあり低迷。下期挽回も対前期比減収減益となった。

連結貸借対照表（要旨）

（単位：百万円）

科目	当期	前期
	平成28年12月31日現在	平成27年12月31日現在
資産の部		
流動資産	31,094	32,163
固定資産	28,081	27,019
有形固定資産	26,710	25,884
無形固定資産	378	419
投資その他の資産	992	716
資産合計	59,175	59,183
負債の部		
流動負債	9,112	9,498
固定負債	5,381	3,869
負債合計	14,494	13,367
純資産の部		
株主資本	44,199	44,293
資本金	8,522	8,522
資本剰余金	8,046	8,046
利益剰余金	27,630	27,723
自己株式	△ 0	△ 0
その他の包括利益累計額	384	1,466
非支配株主持分	96	55
純資産合計	44,681	45,815
負債純資産合計	59,175	59,183

連結損益計算書（要旨）

（単位：百万円）

科目	当期	前期
	平成28年1月1日から平成28年12月31日まで	平成27年1月1日から平成27年12月31日まで
売上高	45,834	48,749
売上原価	33,717	35,116
売上総利益	12,116	13,633
販売費及び一般管理費	11,715	11,909
営業利益	401	1,723
営業外収益	602	712
営業外費用	202	90
経常利益	800	2,344
特別損失	84	—
税金等調整前当期純利益	716	2,344
法人税等合計	550	△ 18
非支配株主に帰属する当期純利益	8	7
親会社株主に帰属する当期純利益	157	2,355

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）

（単位：百万円）

科目	当期	前期
	平成28年1月1日から平成28年12月31日まで	平成27年1月1日から平成27年12月31日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,535	6,448
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,400	△ 7,028
財務活動によるキャッシュ・フロー	497	△ 549
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 392	△ 189
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 1,759	△ 1,318
現金及び現金同等物の期首残高	12,724	14,042
現金及び現金同等物の期末残高	10,964	12,724

株式の状況

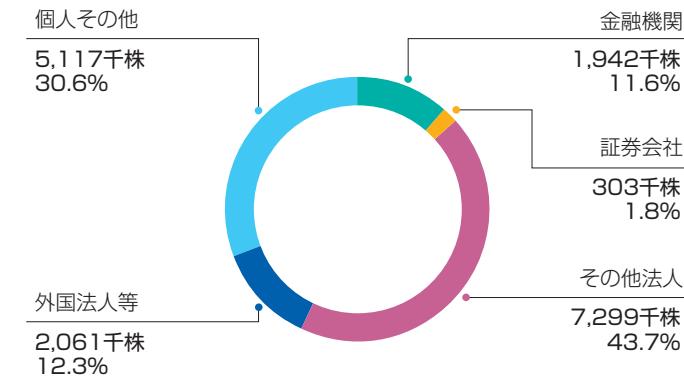
（平成28年12月31日現在）

発行可能株式総数	20,000,000株
発行済株式の総数	16,722,800株
株主数	5,370名
大株主（上位10名）	

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
株式会社ディー・エム・シー	7,200,300	43.05
第一精工従業員持株会	698,880	4.17
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	593,200	3.54
小西英樹	497,600	2.97
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	281,900	1.68
小西達也	240,000	1.43
CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY	226,100	1.35
CACEIS BANK LUXEMBOURG-CLIENT ACCOUNT	213,500	1.27
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	208,900	1.24
京都中央信用金庫	187,600	1.12

所有者別株式分布状況

（平成28年12月31日現在）



会社概要

（平成28年12月31日現在）

商号	第一精工株式会社
設立	昭和38年7月10日
本社所在地	〒612-8024 京都市伏見区桃山町根来12番地4
資本金	85億2,269万円
従業員数	単体:1,755人 連結:5,932人
主要取引銀行	京都銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行

役員

（平成29年3月30日現在）

代表取締役社長	小西英樹
常務取締役	土山隆治
常務取締役	緒方健治
常務取締役	原田隆
常務取締役	田籠康利
取締役	後藤信明
取締役	遠藤隆吉
取締役	原昭彦
取締役	岡田和廣*
取締役(監査等委員)	橋口純一*
取締役(監査等委員)	庭野修次*
取締役(監査等委員)	中田均*

*(社外)